

東芝整流素子 シリコン拡散接合形

3TH62

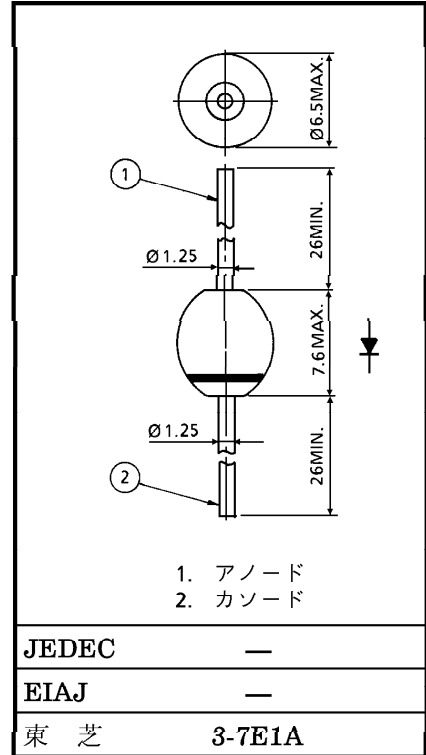
○ 高速用(ファーストリカバリ)

単位 : mm

- 平均順電流 : $I_F(AV)=3A$
- ピーク繰り返し逆電圧 : $V_{RRM}=1500V$
- 逆回復時間 : $t_{rr}=20\mu s$
- ガラスパッシベート整流素子

最大定格

項目	記号	定格	単位
ピーク繰り返し逆電圧	V_{RRM}	1500	V
ピーク非繰り返し逆電圧	V_{RSM}	1600	V
平均順電流	$I_F(AV)$	3	A
ピーク1サイクルサージ電流	I_{FSM}	60 (50Hz)	A
接合温度	T_j	-40~150	°C
保存温度	T_{stg}	-40~150	°C



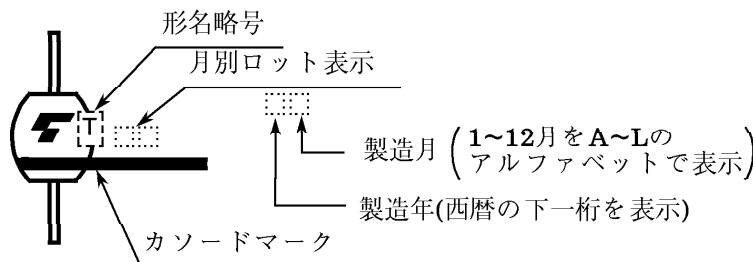
質量 : 1.1g

電気的特性 (Ta = 25°C)

項目	記号	測定条件	最小	最大	単位
ピーク順電圧	V_{FM}	$I_{FM}=3A$	—	1.2	V
ピーク繰り返し逆電流	$I_{RRM}(1)$	$V_{RRM}=1500V$	—	10	μA
	$I_{RRM}(2)$	$V_{RRM}=1500V, T_j=150^\circ C$	—	300	
逆回復時間	t_{rr}	$I_F=20mA, I_R=1mA$	—	20	μs
順回復電圧	V_{fr}	$I_F=1.0A, t_r=15ns, t_w=5\mu s$	—	35	V
熱抵抗	$R_{th(j-a)}$	Junction to Ambient	—	65	°C/W

- 注1. リードのはんだ付けは、リードのつけ根より5mm以上離してはんだ付けしてください。
 2. リードを曲げる場合は、リードのつけ根より5mm以上のところから曲げてください。

現品表示

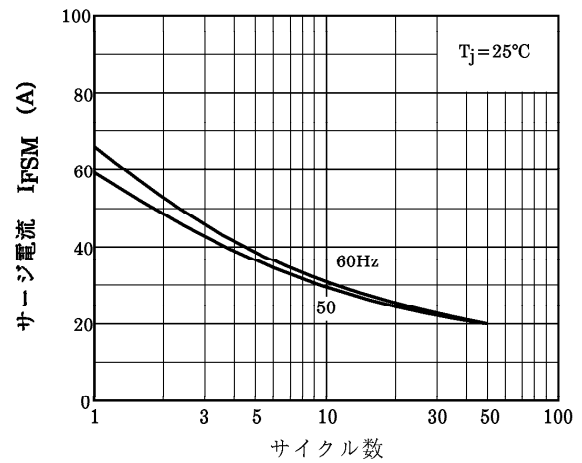
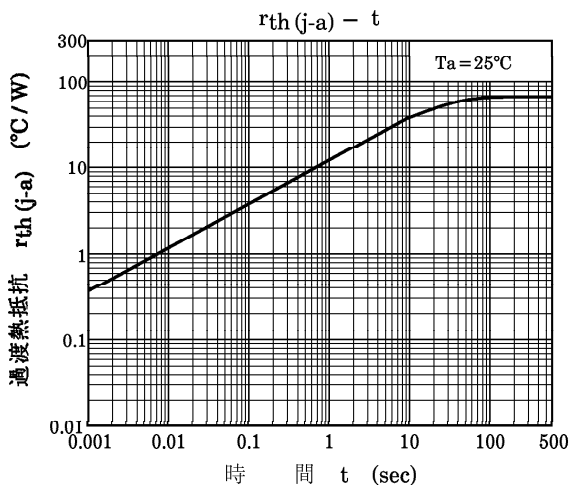
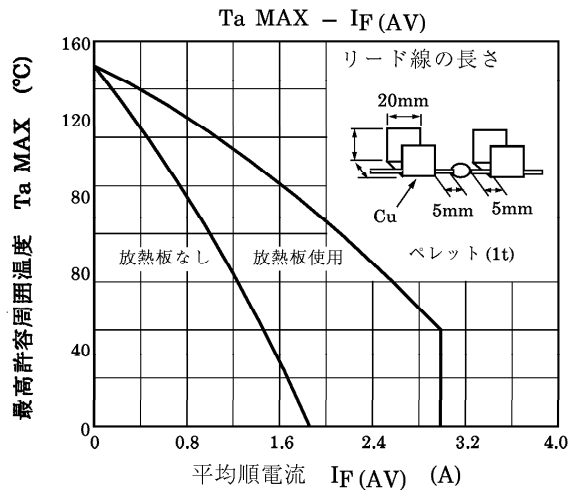
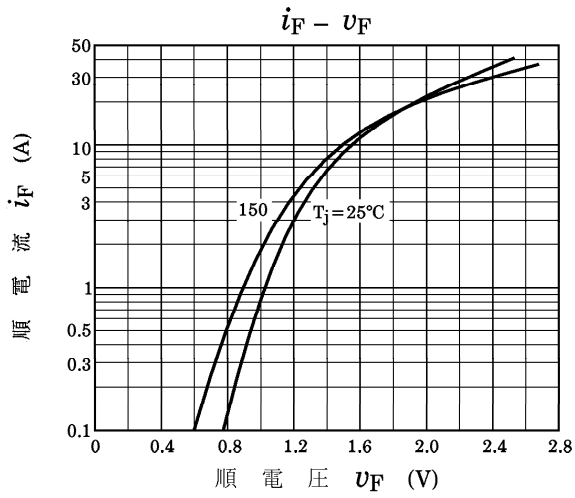


捺印液 : 黒

略号	形名
T	3TH62

TA1

● 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、一般に半導体製品は誤作動したり故障することがあります。当社半導体製品をご使用頂く場合は、半導体製品の誤作動や故障により、他人の生命・身体・財産が侵害されることのないように、購入者側の責任において、装置の安全設計を行うことをお願いします。なお、設計に際しては、最新の製品仕様をご確認の上、製品保証範囲内でご使用頂くとともに、考慮されるべき注意事項や条件について「東芝半導体製品の取り扱い上のご注意とお願い」、「半導体信頼性ハンドブック」などをご活用ください。



TA1'

● 本資料に掲載されている技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社および第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
● 本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。